



主要特点

- 高导热性、低膨胀系数
- 良好的平面度
- 高刚度,更优异的耐磨性
- 轻量化设计
- 高纯度,无金属离子污染
- 可根据用户需求进行结构定制

性能简介

吸盘采用轻量化设计,并采用和硅材料热膨胀系数相近材料:无压烧结碳化硅,渗硅碳化硅,氮化硅和氮化铝等。吸盘具备高刚度,高导热,低热膨胀,稳定性高等特点,另外,还具备高纯度,晶粒大小均匀等特性,如此可有效的减少Particle以及化学清洗的污染问题,延长使用寿命。

主要应用

- 光刻设备
- 半导体量检测设备,如膜厚测量,OCD 测量,形貌测量,缺陷检测等

技术参数

	数据	单位
平面度/Flatness	0.5	μm
适用规格/Applicable specifications	6/8' 12' 8/12'	
表面特征/Surface feature	pin type, ring type	
Pin高度/Pin height	0.05-0.2	mm
Pin直径(最小)/Pin min. diameter	φ0.2	mm
Pin间距(最小)/Min. spacing	3	mm
密环宽度(最小)/Min. seal width	0.7	mm
表面粗糙度/Surface roughness	Ra 0.02	μm
厚度公差/Thickness tolerance	±0.01	mm
直径公差/Diameter tolerance	±0.01	mm
平行度公差/Parallelism tolerance	≤3	μm